

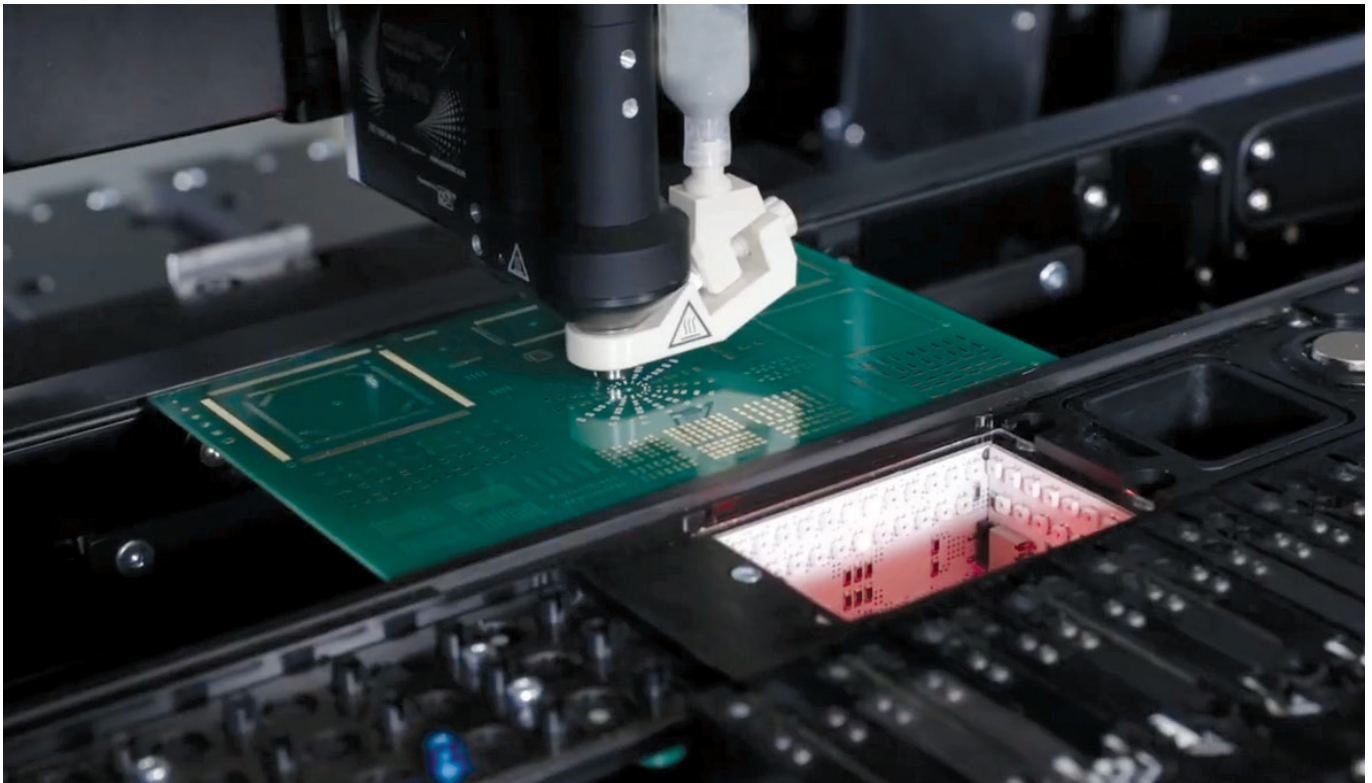
NEWSLETTER

VERMES Microdispensing und GENMA stellen neue Lösung für Lötpasten-Jet-Dosierung mit herausragend kleiner Tropfengröße vor

Die jüngste Zusammenarbeit zwischen VERMES Microdispensing - einem Marktführer in der Entwicklung und Herstellung innovativer Mikrodosiersysteme - und GENMA - einem international führenden Hersteller von höchstwertigen Lötpasten - führte zu einer neuen Anwendung für ein schnelles und

zuverlässiges Verfahren zum Aufbringen kleinster Lötpastenmengen in der Elektronikfertigung.

Eine der Hauptanwendungen für Lötpastendosierung ist die Montage elektronischer Bauteile in der Leiterplattenbestückung. Ein weiterer bedeutender Anwendungsbereich ist das Modul Packaging.



Beide Prozesse erfordern höchste Dosierqualität und stabilste Prozessbedingungen.

Viele auf dem Markt erhältliche Systeme basieren auf alten Technologien, die die heutigen Marktanforderungen für eine höhere Betriebsgeschwindigkeit bei kleinerer Tropfengröße nicht erfüllen können. Die VERMES Microdispensing Systeme hingegen basieren auf sogenannten Jetventilen mit denen die Materialien berührungslos, schnell und präzise aufgetragen werden können.

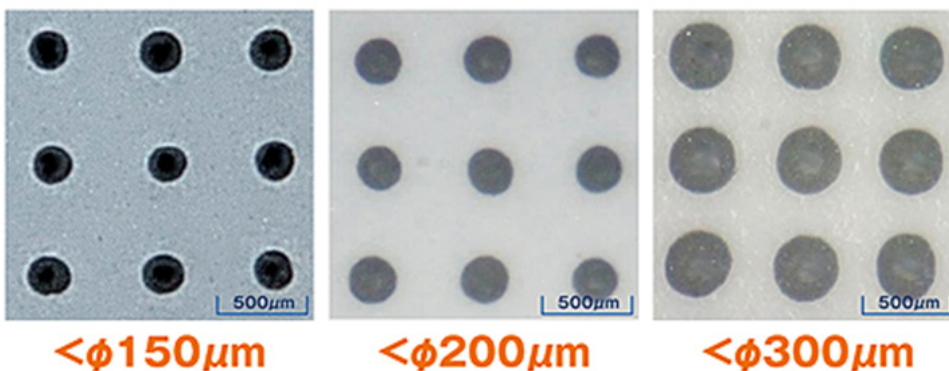
„GENMA sucht ständig nach Verbesserungen und neuen technischen Lösungen für unsere Kunden. In Zusammenarbeit mit VERMES Microdispensing können wir jetzt eine hervorragende Lötpastenlösung anbieten, um aktuelle technische Herausforderungen zu lösen. Die winDot Lötpaste von GENMA kann in automatisierten Dosierprozessen sicher in einer

Punktgröße von 130µm aufgebracht werden“, erklärt Stefan Komenda, CEO von GENMA Europe.

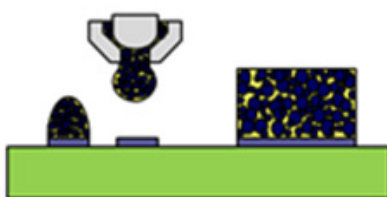
„Die Vorteile des VERMES Mikrodosiersystems MDS 1560, das auf unserer revolutionären Aktortechnologie DST (Dynamic Shockwave Technology) basiert, in Kombination mit GENMA winDot Lötpaste bieten unseren Kunden optimale Ergebnisse bei der Lötpastendosierung auch bei kleinster Tropfengröße“, fügt Jürgen Städtler, CEO der VERMES Microdispensing, hinzu.

Das VERMES Mikrodosiersystem MDS 1560 kann problemlos in zahlreiche Maschinenplattformen wie Dosierroboter und Schablonendrucker integriert werden.

High-End-Design und erweiterte Funktionen erfordern, dass die Elektronik kontinuierlich kleiner wird. Das neue VERMES MDS 1560-System mit seinen optimierten Eigenschaften in



Verschiedene Punktgrößen, die mit dem Mikrodosiersystem VERMES MDS 1560 und der GENMA winDot Lötpaste dosiert wurden.



Für das Modul Packaging werden kleinste Löt-pastendepots benötigt.



Jet-Dosieren von kleinen Pads zusätzlich zum Schablonendruck.

Kombination mit der GENMA winDot Lötpaste ermöglicht das Dosieren kleinster Punkte in einem hochstabilen Prozess mit einer hohen Geschwindigkeit. Neben Geschwindigkeit und Punktgröße ist Zuverlässigkeit von besonderer Bedeutung. Das neue Jetverfahren bietet eine Lösung, die kontinuierlich Spitzenenergebnisse liefert. Das Ventil kann mehr als eine Million Punkte hintereinander dosieren, ohne dass ein Operator-Eingriff notwendig wird.

In der Elektronikfertigung dosiert diese Systemlösung problemlos Lötpaste in kleinsten Punktgrößen und kann damit die Dichte auf Platinen erhöhen. Die GENMA winDot Lötpaste kann auf Pads für die kleinste derzeit verwendete Chipkomponente, die als 01005 bezeichnet wird, dosiert werden.

In der Prototypenfertigung und der Produktion in kleinem Maßstab (small-scale production) ist das VERMES Mikrodosiersystem MDS 1560 in Kombination mit der GENMA winDot Lötpaste wesentlich produktiver als der Schablonendruck.

Das VERMES Mikrodosiersystem MDS 1560 kann problemlos in zahlreiche Maschinenplattformen

wie Dosierroboter und Schablonendrucker integriert werden.

Wo das Drucken von kleinen Lötpasten-Depots nicht möglich ist, wie etwa bei flexiblen Leiterplatten und 3D-MIDs (3-Dimensional Moulded Interconnected Devices), bietet die Systemlösung die schnellste und präziseste Möglichkeit Lötpaste aufzubringen.

Zweifellos ist die Jetting-Technologie wesentlich schneller als Nadeldosierung und Pintransfer und liefert präzisere Ergebnisse.

Durch die höhere Genauigkeit kann die Produktionsausbeute im Vergleich zu den derzeit verwendeten Lötpasten-Auftragsverfahren erheblich gesteigert werden. Kleine Punktgrößen in Kombination mit hoher Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit liefern auch große Vorteile für die Produktionsprozesse im Modul Packaging, wie PoP-Modulen (Package on Package), CSP-Modulen (Chip Scale Packages), 3D-Leiterplatten, und zur Montage von RF Shields.

VERMES Microdispensing GmbH
Rudolf-Diesel-Ring 2
83607 Holzkirchen | Germany

+49 (0) 8024 6 44 0 | +49 (0) 8024 6 44 19

sales@vermes.com | www.vermes.com

Germany
+49 (0)8024 644 - 0
info@vermes.com

China
+86 (0)592 7257233
info@vermes.com

USA
+1 408 520-2555
america@vermes.com

Korea
+82 (0)32-246-1500
korea@vermes.com

Malaysia
+60 4 358 0996
info@vermes.com

